

ADVANTEST[®]

2023年度（2024年3月期） 第1四半期決算説明会

2023年7月26日
株式会社アドバンテスト

All Rights Reserved - ADVANTEST CORPORATION

ご注意

会計基準について

- 本プレゼンテーション資料に記載されている実績や見通し数値は、国際会計基準（IFRS）に基づいて作成しています。

将来の事象に係る記述に関する注意

- 本プレゼンテーション資料およびアドバンテスト代表者が口頭にて提供する情報には、将来の事象についての、当社の現時点における期待、見積りおよび予測に基づく記述が含まれております。これらの将来の事象に係る記述は、当社における実際の財務状況や活動状況が、当該将来の事象に係る記述によって明示されているものまたは暗示されているものと重要な差異を生じるかもしれないという既知および未知のリスク、不確実性その他の要因が内包されており、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。

本資料の利用について

- 本プレゼンテーション資料に記載されている情報は、各国の著作権法、特許法、商標法、意匠法等の知的財産権法その他の法律及び各種条約で保護されています。事前に当社の文書による承諾を得ない限り、法律によって明示的に認められる範囲を超えて、これらの情報を使用（改変、複製、転用等）することを禁止します。



```
...mirror_ob.select = 0
operation == "MIRROR_X":
    @mirror_mod.use_x = True
    @mirror_mod.use_y = False
    @mirror_mod.use_z = False
    operation == "MIRROR_Y":
    @mirror_mod.use_x = False
    @mirror_mod.use_y = True
    @mirror_mod.use_z = False
    operation == "MIRROR_Z":
    @mirror_mod.use_x = False
    @mirror_mod.use_y = False
    @mirror_mod.use_z = True

selection at the end -add @
@mirror_ob.select- 1
@mirror_ob.select-1
context.scene.objects.active
["Selected" + str(modifier)]
@mirror_ob.select = 0
```

2023年度第1四半期決算報告

経営執行役員

CFO(Chief Financial Officer) & CSO(Chief Strategy Officer)

経営戦略本部長 三橋 靖夫

All Rights Reserved - ADVANTEST CORPORATION

ADVANTEST[®]

四半期業績推移

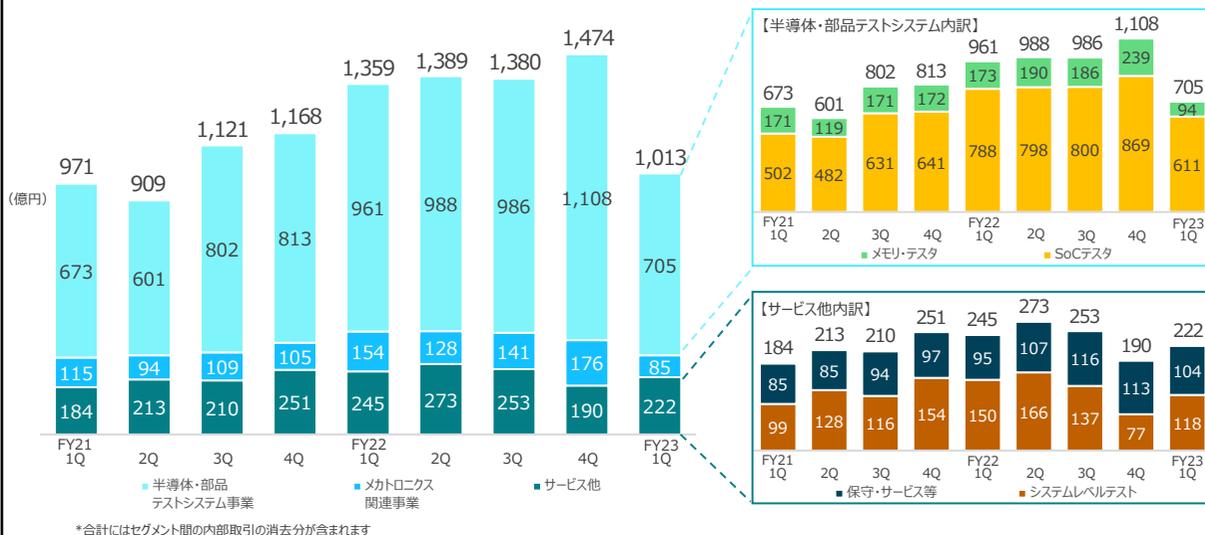
(億円)

	FY22				FY23 1Q	FY23			
	1Q	2Q	3Q	4Q		前期比		前年同期比	
						増減額	増減率	増減額	増減率
売上高	1,359	1,389	1,380	1,474	1,013	-461	-31.3%	-347	-25.5%
売上総利益	789	799	816	787	510	-277	-35.3%	-280	-35.4%
売上総利益率	58.1%	57.5%	59.1%	53.4%	50.3%	-3.1pts		-7.8pts	
営業利益	448	431	412	386	143	-243	-63.0%	-305	-68.1%
営業利益率	32.9%	31.1%	29.9%	26.2%	14.1%	-12.1pts		-18.8pts	
税引前四半期利益	484	468	377	384	130	-255	-66.3%	-355	-73.2%
四半期利益	365	347	286	306	92	-214	-69.9%	-273	-74.8%
四半期利益率	26.8%	25.0%	20.8%	20.8%	9.1%	-11.7pts		-17.7pts	
為替レート	1米ドル	124円	135円	144円	133円	135円	2円 円安	11円 円安	
	1ユーロ	134円	139円	144円	142円	146円	4円 円安	12円 円安	

○ 2023年度第1四半期の業績概要

- 第1四半期の当社を取り巻く事業環境は、4月時点での予想通り厳しい環境となりました。
- 前年度から継続する景気後退懸念が高まる中で、スマートフォンやパソコンなど主要民生機器関連での需要減退に加え、データセンタ投資も減速し最終需要の低迷が続いています。
- 半導体市場においても、これら主要民生機器関連向けのメモリ半導体など、関連する半導体メーカーの在庫調整や設備投資の抑制が継続したことから、全体としては減速感が強まりました。
- 半導体市場が弱含む中で、当社ビジネスにおいても、過去3年継続した顧客の投資により、一部の顧客サプライチェーンでは試験装置の余剰が発生していることから、需要が落ち込みました。
- このようなことから、第1四半期は売上、利益ともに、前期比および前年同期比ともに大きく減少しました。
- 実績詳細は以降のスライドで順次ご説明いたします。

四半期売上高 事業セグメント別



○ 2023年度第1四半期の売上高

- ・ 四半期ベースで過去最高の売上高を計上した前期と比べ、第1四半期の売上高は大きく減少しました。

○ 半導体・部品テストシステム事業

- ・ 前期比36.3%減 705億円
- ・ SoCテストは、前期比257億円減の611億円でした。アプリケーション・プロセッサ（APU）やハイ・パフォーマンス・コンピューティング（HPC）用半導体向けの売上が落ち込みました。
- ・ メモリ・テストは、前期比145億円減の94億円でした。メモリ半導体市況が低調な中、DRAMおよび不揮発性メモリ向けともに売上が減少しました。

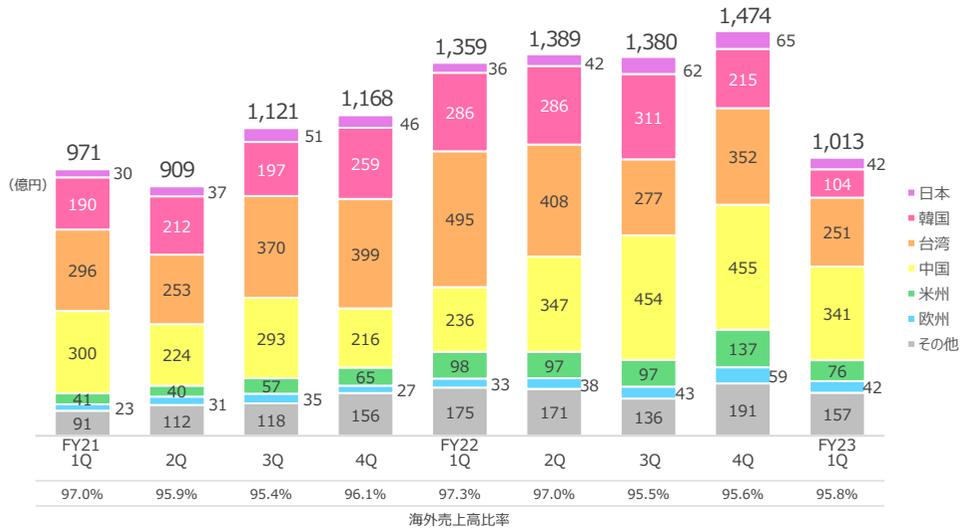
○ メカトロニクス関連事業

- ・ 前期比51.3%減 85億円
- ・ テスタの販売減に連動してデバイス・インタフェース、テスト・ハンドラの売上がそれぞれ減少しました。ナノテクノロジー製品の売上も、前期に製品納入が進んだことによる反動減で落ち込みました。

○ サービス他

- ・ 前期比16.4%増 222億円
- ・ システムレベルテスト（SLT）部門において前期比売上が増加しました。

四半期売上高 地域(出荷先)別



○ 2023年度第1四半期の地域別売上高

- 第1四半期は前期と比較し、どの地域においても売上が減少しました。
- 韓国
特にメモリテストおよび関連するデバイス・インタフェースの売が大きく落ち込みました。
- 中国、台湾
SoCテストおよびメモリテストでそれぞれ売上が減少しました。

売上高/売上総利益/営業利益



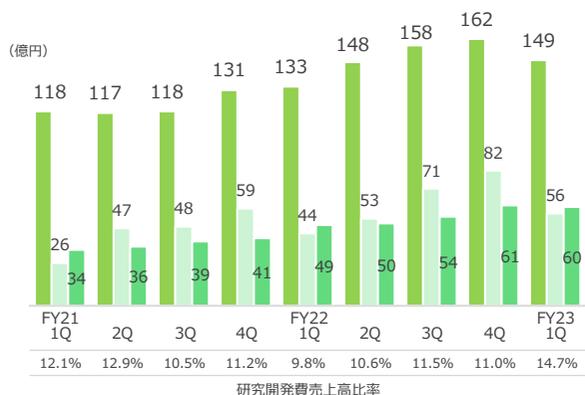
○ 2023年度第1四半期の売上高/売上総利益/営業利益

- 売上総利益率 50.3%
- 大幅な減収に加え、ハイエンドSoC向けテストの売上構成比率が低下したことなどによるミックス悪化により、売上総利益率が低下しました。
- 売上総利益率は第1四半期をボトムとし、第2四半期以降は改善を見込んでいます。
- 販売費および一般管理費等（その他収益・費用を合算） 367億円
- 営業利益 143億円
- 営業利益率 14.1%

投資等/キャッシュ・フロー

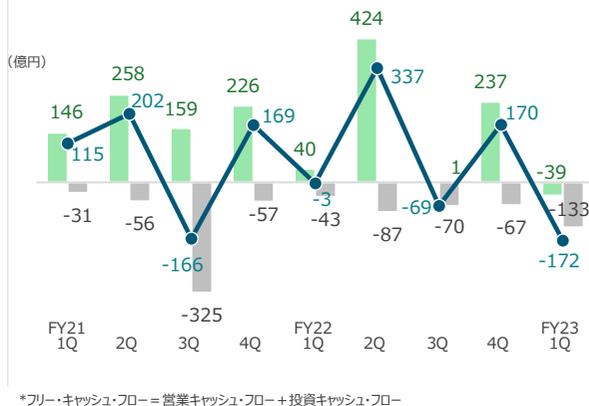
<投資等>

- 研究開発費
- 設備投資
- 減価償却費



<キャッシュ・フロー>

- 営業キャッシュ・フロー
- 投資キャッシュ・フロー
- フリー・キャッシュ・フロー



*フリー・キャッシュ・フロー = 営業キャッシュ・フロー + 投資キャッシュ・フロー

○ 2023年度第1四半期の研究開発費等

- 研究開発費 149億円
- 設備投資 56億円
- 減価償却費 60億円

○ 2023年度第1四半期のキャッシュ・フローの状況

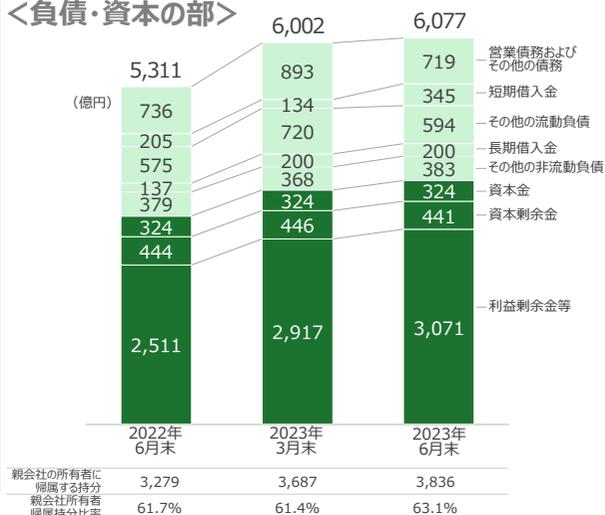
- 第1四半期は棚卸資産の増加や法人税、賞与の支払いなどから、営業キャッシュ・フローがマイナスとなりました。
- 加えて、投資キャッシュ・フローにおいてShin Puu社の買収などの支出があり、フリー・キャッシュ・フローは、172億円の支出となりました。

連結財政状態

<資産の部>



<負債・資本の部>



○ 2023年6月末時点のバランス・シート

- 総資産 6,077億円
- 現金および現金同等物 789億円
- 営業債権およびその他の債権 660億円
第1四半期で売掛金の回収が進んだため、前期比で営業債権およびその他の債権が減少しました。
- 棚卸資産 1,902億円
中長期の売上を見据え、戦略的に調達した長納期部材の納入が増えている一方で、民生品の需要回復の遅れを背景に当社製品の納入延伸要求も一部あることから、棚卸資産が前期比で増加しています。市況の変化に応じ、顧客要求への追従力を高める施策を推進するとともに、棚卸資産管理の強化に努めてまいります。
- のれんおよび無形資産 1,059億円
- 短期借入金 345億円
第1四半期での決算資金の支出を考慮し、追加の借入を実行しました。
- 親会社の所有者に帰属する持分 3,836億円
- 親会社所有者帰属持分比率 63.1%



2023年度事業見通し

代表取締役 兼 執行役員社長 Group CEO 吉田 芳明

All Rights Reserved - ADVANTEST CORPORATION

ADVANTEST[®]

事業環境と半導体テスト市場の動向 <23年7月時点の見方>

<事業環境：不確実性の高い状況が継続>

- インフレ進行や金利上昇などによる景気後退、地政学的リスクの拡大や急速な為替変動リスクなど不確実性が高い状況が継続

<半導体市場：主要民生機器向け需要の低迷が続く>

- 自動車や産業機器向けなどの一部の半導体需要は堅調なもの、スマートフォンなど主要民生機器向けでの半導体需要減退に加え、データセンタ投資も減速したことから、関連する半導体メーカーでの生産調整は当面継続するものと見込む

<半導体テスト市場：2年連続で規模縮小を見込む>

- 高性能半導体向けのテスト量は増加しているものの、顧客サプライチェーンに設備の余剰もあり、テスト需要の回復は期初の想定よりも緩やかになると予想

	CY22実績	CY23推定	CY23推定 4月時点推定との差
SoCテスト市場	約\$4.0B	約\$3.2B-3.5B (4月時点推定: 約\$3.4B - 3.8B)	スマートフォン関連向けを中心に 市場規模引き下げ
メモリ・テスト市場	約\$1.2B	約\$0.9B-1.1B (4月時点推定: 約\$0.9B - 1.1B)	-

Source: Advantest

○ 事業環境と半導体テスト市場の見方

- インフレの進行や金利上昇などによる、世界経済の景気後退に加え、地政学的リスクの拡大や急激な為替変動リスクなど、事業環境は不確実性の高い状況が継続しています。
- 生成AIなどに触発され、高性能半導体需要は上向き兆しを感じられるなど、アプリケーションごとに濃淡はあるものの、主要民生機器向けなどの半導体メーカーにおける生産調整は、当面継続されると予想しています。
- 2023年のSoCテスト市場は、米ドルで32億ドルから35億ドルの間と市場規模予想を引き下げます。車載・産機向けのテスト需要は底堅さを見込む一方、スマートフォン関連向けなどの民生機器向けテスト需要の低迷が当面継続する影響を受けるとみています。
- 2023年のメモリ・テスト市場は、米ドルで9億ドルから11億ドルの予想を据え置きます。高性能メモリ向けでの需要は上向いているものの、民生関連向けメモリ半導体市況の悪化の影響を受けたテスト需要低下が相殺するとみています。
- 半導体テスト市場は、高性能半導体向けでテスト量は増加するものの、顧客サプライチェーンに設備の余剰もあり、テスト需要の回復は期初の想定よりも緩やかになると予想します。

FY23業績予想

(億円)

	FY22 実績	FY23						前年度比		(参考)新旧予想比較	
		1Q実績	2Q予想	上期予想	下期予想	通期予想	増減額	増減率	4月時点 FY23予想	修正額	
売上高*1	5,602	1,013	1,127	2,140	2,660	4,800	-802	-14.3%	4,800	-	
営業利益	1,677	143	223	366	684	1,050	-627	-37.4%	1,050	-	
営業利益率	29.9%	14.1%	19.8%	17.1%	25.7%	21.9%	-8.0pts		21.9%	-	
税引前利益	1,713	130	222	352	683	1,035	-678	-39.6%	1,035	-	
当期利益	1,304	92	168	260	520	780	-524	-40.2%	780	-	
当期利益率	23.3%	9.1%	14.9%	12.1%	19.5%	16.3%	-7.0pts		16.3%	-	
研究開発費	601	149	161	310	320	630	+29	+4.8%	630	-	
設備投資	250	56	52	108	102	210	-40	-16.0%	210	-	
減価償却費	214	60	58	118	122	240	+26	+12.1%	230	+10	
為替レート*2	1米ドル	134円	135円	135円	135円	135円	135円	1円 円安	130円	5円 円安	
	1ユーロ	140円	146円	150円	148円	150円	149円	9円 円安	140円	9円 円安	

*1: 合計にはセグメント間の内部取引の消去分が含まれます

*2: 為替レート変動が今年度の営業利益に与える影響の最新見通しは、対米ドルが1円安時+11億円です。対ユーロは-3億円です

12 | ADVANTEST

All Rights Reserved - ADVANTEST CORPORATION

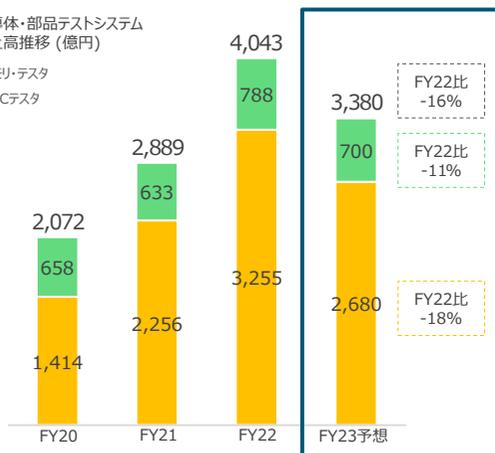
○ 2023年度の業績予想

- 第1四半期実績と今後の見通しを踏まえ、当連結会計年度の通期連結業績予想は、4月に公表した予想を据え置きます。ただし、第2四半期以降の予想の前提とした為替レートは、米ドルが135円、ユーロが150円と変更しています。
- 売上高4,800億円、営業利益1,050億円、税引前利益1,035億円、当期利益780億円を見込みます。
- 顧客の生産調整は当面継続する見込みであり、前年度下期と比べ上期は売上が落ち込むとみっていますが、下期から徐々に増加傾向に転ずると想定しています。
- 通期の売上総利益率は、およそ55%を想定しています。主に製品ミックスの変動で前年度から悪化を見込みます。
- 為替レート変動が2023年度の営業利益に与える影響の最新見通しは、通期で対米ドルでは1円安時+11億円、対ユーロでは-3億円です。
- なお米国および同盟国による半導体製造装置の対中輸出規制強化に関して、現時点では、当社の2023年度の業績に対する直接的な影響は限定的と考えておりますが、状況を注視してまいります。

FY23見通し（事業別）

半導体・部品テストシステム
売上高推移（億円）

■ メモリ・テスト
■ SoCテスト



半導体・部品テストシステム事業

<SoCテスト>（4月予想比 +30億円）

– 車載・産業機器向けは比較的堅調なもの、スマートフォンの市況弱含みを背景に先端プロセス品向けの需要の落ち込みを想定

アプリケーション別内訳	FY20	FY21	FY22	FY23(予)
コンピューティング・通信	55%	60%	65%	60%
車載・産業機器・民生・DDIC*	45%	40%	35%	40%

内訳比率は実数ではなく、5%近似値で丸めて表示しています

<メモリ・テスト>（4月予想から変更なし）

– 高性能メモリ向けでは需要増を見込む一方、民生向けメモリの市況悪化を受け減収見通し

アプリケーション別内訳	FY20	FY21	FY22	FY23(予)
DRAM	60%	60%	60%	80%
不揮発性メモリ	40%	40%	40%	20%

内訳比率は実数ではなく、5%近似値で丸めて表示しています

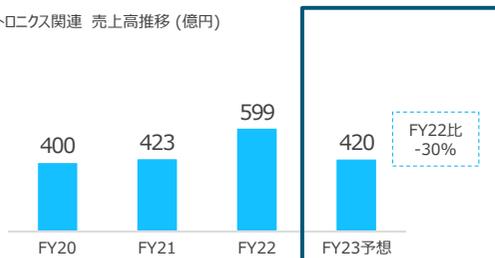
* DDIC:ディスプレイ・ドライバーIC

○ 半導体・部品テストシステム事業の今期見通し

- SoCテストの2023年度通期売上予想は2,680億円です。
- 4月の見通しからは米ドルの想定為替レートを円安方向に見直したため、30億円引き上げています。
- 車載・産業機器向けは比較的堅調なもの、スマートフォンの需要低迷などを背景とした先端プロセス品向けの需要の落ち込みを受け、前年度比減収を想定しています。
- メモリ・テストについては700億円と売上予想を据え置きます。
- DDR5やHBMといった高性能メモリ向けでは、長期的な需要拡大を見据え顧客の投資は前年度より増加する見込みです。しかしながら民生関連でのメモリ半導体の市況悪化の影響が大きく、こちらも減収見通しです。

FY23見通し（事業別）

メカトロニクス関連 売上高推移（億円）

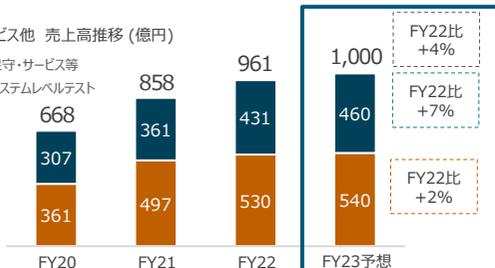


メカトロニクス関連事業（4月予想比 -30億円）

– テスタ投資減速に伴い、デバイス・インタフェース製品やテスト・ハンドラは減収を予想

サービス他 売上高推移（億円）

■ 保守・サービス等
■ システムレベルテスト



サービス他事業（4月予想から変更なし）

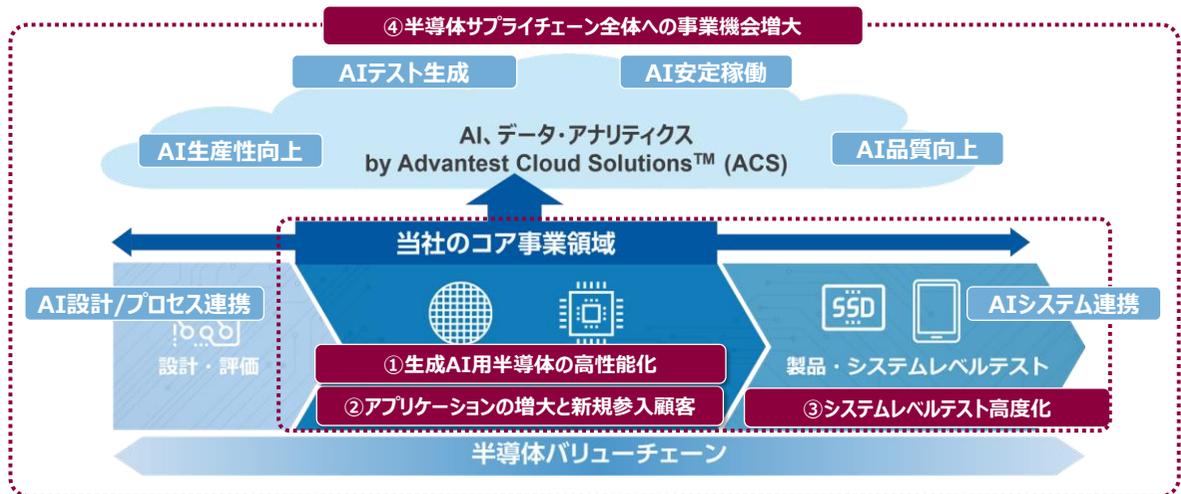
– 当社製品の設置台数の着実な伸びにより、保守サービスの需要は堅調

– システムレベルテスト事業は民生機器関連での市況低迷の影響を受けているが、前年度並みの売上を見込む

○ メカトロニクス関連、サービス他事業の今期見通し

- メカトロニクス関連事業の、2023年度通期売上予想は4月から30億円引き下げ、420億円とします。
- テスタ投資減速に伴い、関連するデバイス・インタフェース製品やテスト・ハンドラの売上が減少する見込みです。
- サービス他事業については、2023年度通期売上予想1,000億円を据え置きます。
- 当社製品の設置台数の着実な伸びを受けて、サービス保守事業の底堅い需要を見込んでいます。
- システムレベルテスト事業においては、民生機器関連での市況低迷の影響を受けておりますが、前年度並みの売上を見込んでおります。

生成AIがもたらす当社の事業機会①



○ 生成AIがもたらす当社の事業機会①

- ここまで、今期の事業見通しについてご説明してきましたが、ここで中長期的な視点でここ半年ほど話題を集めた生成AIがもたらす当社の事業機会と当社の優位性について整理してみたいと思います。この図は当社のグランドデザインチャートに事業機会をまとめてみたものです。
- Chat GPTなど、生成AI技術の社会実装に向けての進展は始まったばかりです。演算処理能力の高いハイエンドSoCや、HBMといったハイエンドメモリなど、半導体の大規模化、高性能化はさらに進んでいきます。歩留まり向上の技術的難易度も高く、より入念なテストが求められます。このような半導体の生産増加が中長期的にテストの需要を高め、当社コア事業の成長をけん引すると考えています。
- また、サーバーのみならず、エンドアプリケーション側でもより多様な機能を求める動きが、半導体の設計に参入する新たなプレーヤーの増加という動きとして表れています。開発するデバイスの増加もテスト需要を後押しします。
- 先端パッケージ技術の採用によるシステム化により、いっそうの高性能化を実現する取り組みも進んでいます。当社はシステムレベルテスト技術を強化してきており、SoC,メモリそしてシステムレベルテストと様々なテスト工程で半導体の品質向上に貢献することができます。
- さらに今後は、生成AI技術が半導体開発・製造におけるプロセスそのものを変えていく可能性が高いと考えています。様々なデータを活用し開発、製造に活かしていく取り組みに当社はAdvantest Cloud Solutions™ (ACS) を通じて新たなソリューションを提供していきたいと考えています。

生成AIがもたらす当社の事業機会②

・ 生成AIに必要となる高性能デバイスの試験に最適な製品ポートフォリオ

- － GPUやCPU、さらにはHBMなどの高性能メモリといった、複雑で高性能な生成AI用デバイス試験に必要となるSoCおよびメモリデバイス向けテストプラットフォームをすべて保有
- － 2.5D、3Dなどの先端パッケージ採用が需要をけん引するシステムレベルテストの技術を保有

・ AI/HPC市場における強固な顧客基盤

- － 既存AI/HPC関連顧客のサプライチェーン全体との確立されたパートナーシップ
- － 生成AIの社会実装に向け、多様な新規市場参入者と協業開始

・ 半導体産業でのTime to Market、Time to Quality、Time to VolumeにAIを活用したデータ・プラットフォームサービスを提供

- － Advantest Cloud Solutions™を通じたデータ・アナリティクスサービスを顧客とともに開発中

○ 生成AIがもたらす当社の事業機会②

- ・ 前ページの事業機会に対し、当社の優位性を改めて整理します。
- ・ 第一に、当社は高性能半導体を試験するためのSoC、メモリ、そしてシステムレベルテスト向けといった、それぞれのテストプラットフォームを既に保有しています。
- ・ 第二に、当社はこれらプラットフォームを既に利用しているファブレス、ファウンダリー、OSATにいたるサプライチェーンで広く強固な顧客基盤を構築しています。新たな市場参入者は、この強固な顧客基盤を評価し、当社のソリューションに期待してわれわれと協業を開始しています。
- ・ 最後に、生成AIは半導体サプライチェーンにおける業務プロセスも大きく変える可能性を秘めています。半導体の開発、製造、試験において様々なデータをどう活用していくかが競争力に直結するようになるものと予想します。テストデータという半導体製造における不可欠のデータを軸に、他のデータと連携するデータ・プラットフォームを顧客に提供する予定です。さらにそれらのデータを活用するアプリケーションをAdvantest Cloud Solutions™として開発していく予定です。顧客との共同開発が鍵になると考えていますが、当社でも半導体プロセス全体に知見のあるタレントの採用などの投資を積極化しています。

サマリー

・ 事業環境の不確実性は高い状況が継続

- － インフレ進行、金利上昇、為替変動、米国による対中国輸出規制、地政学的リスクなど世界経済への下押し圧力継続

・ 半導体テスト市場の需要はアプリケーションごとにまだら模様

- － 高性能SoC半導体用のテスト需要は上向くも、テスト設備の余剰消化にはなお時間を要する
- － 車載向けSoC半導体用および高性能メモリ半導体用のテスト需要は底堅く推移

・ 通期業績予想達成に邁進するとともに、中長期的な需要の波に備え、主要施策を実行

- － 生成AI技術の社会実装はこれから。半導体サプライチェーン上で当社の事業機会最大化のための投資を継続
- － 経営判断の更なるスピード向上のためCxO体制見直しと事業プロセスの見直し

○ サマリー

- ・ 当社の事業環境は、不確実性の高い状況が継続しています。
- ・ 足元の半導体テスト市場は、世界経済の回復の遅れによりテスト設備の余剰が発生しており、その消化に時間を要する調整局面が続いています。高性能半導体向けのテスト需要は上向くものの、テスト需要の回復は期初の想定に比べて緩慢なペースで推移しています。
- ・ 車載向け半導体や高性能半導体のテスト需要は底堅いと見込みますが、携帯やパソコン向けなどの落ち込みを補うにはまだ力不足であり、2023年度の減収減益見通しに変更はありません。
- ・ 事業環境は弱含みですが、環境変化に機敏に対応し、通期業績予想の達成に邁進するとともに、中長期的な今後の需要の波に備え、主要施策を実行します。
- ・ 生成AIの社会実装は緒についたばかりではありますが、来年以降、生成AIに関連する高性能半導体のテストビジネス需要増加に期待しています。関連する事業機会を最大限取り込むための施策を中長期視点で実行していきます。
- ・ また、経営判断のさらなるスピード向上のため、執行体制の見直しや業務プロセスの改善を図り、より強固で強靱な経営基盤づくりを目指します。

ESG・外部評価関連トピックス（2023年4月～7月）

● TechInsights社顧客満足度調査にて 4年連続第1位を獲得

※当社プレスリリース：<https://www.advantest.com/ja/news/2023/20230522.html>



● アドバンテスト、NXP Semiconductors社、 アリゾナ州立大学が共同で初のテスト・エン 지니어リング・コースを開始

※当社プレスリリース：<https://www.advantest.com/ja/news/2023/20230621.html>



※新しいコースのために開発したテスト回路を確認する様子

○ ESG・外部評価関連トピックス

- 最後に、今年度のESG・外部評価トピックスを紹介します。
ESGのさらなる推進は我々のグランドデザインの5つ目の戦略です。
- このスライドは直近の主な実績です。外部評価として、半導体製造装置メーカー顧客満足度調査にて4年連続の第1位を獲得しました。今年も世界中のお客様から私たちのパートナーとしての努力に高い評価をいただいたことに感謝するとともに、グループ従業員の持続的な取り組みを誇りに思います。
- ESGのさらなる推進を通じて、当社の発展を目指すと同時に、半導体業界の発展と社会の持続的発展に貢献し、ステークホルダーの期待に応えていきたいと考えています。
- 私からの説明は以上となります。

ADVANTEST®